		RM F			_					TMENT OF COM		SERIAL NO.	ŀ	ROUP ART UNIT ATTACHMENT				
												10-07	28	ZP17 PAPER 4				
			NO	Ti	CE (	OF F	REF	ER	ENC	ES CITED		Sutardja						
											U.S. PATE	ENT DOCUM	Tard ENTS	ja				
				DOCUMENT NO.						DATE .	NAME			CLA		SUB- CLASS		G DATE II
İ	A					7-3			2									
Ì	┪	В		1221319-19-2000				Q 16 -7000	-Te Anson			360	17-	7.02				
ł	_	С	•					1-14-200	1-19-2000 Jepp		<u> </u>							
		D	H		H									<del> </del>	-			
			H				-						<u>_</u>					<del></del>
		Ε	-	_		-	┞								-		<u> </u>	
		F	L	-	_	<u> </u>	-							-			ļ	<del></del>
		G	G					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·								
		Н	<u> </u>					L				·						
		Ľ	L	L	L		_					_						
		ı			:. -:	-												
		κ		Ŀ			Ĺ		·		+		·					
		FOREIGN PATENT DOCUMENTS																
	DOCUMENT			NT, P	NO. DATE			COUNTRY		NAME		CLASS	CLASS SUB		HTS. PP			
		Ŀ	8	\$ 06 1 75 Z			Z	3-4-1994	Japan		Matsur	ams ctel	330	30	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
		м					::/ 14		¥									
		N	£.p.															
		0				•												
	r	P	T		7	$I^-$	l											
	-	\ \ \			i.												7	
41	OTHER REFERENCES (Including Author, Title, Date, Pertinent Pages, Etc.)																	
• .		TIV L. L. AA NESTE															1.1	
	Gm-C compensation for low-voltage application" IEE  International Solid-State Circuits Conference, 1997 Di													TEL				
														1				
<i>&gt;</i> -														1 Jes 24				
446	<u>C</u> F	of lechnical Papers, 44" ISSCC February 6-8, 1987 pp 348. That "Electronic Circuite Digital and Analog" John													178-37			
A CONTRACT	10 1 10 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10															<del></del>		
	**	Ü				<b>2000</b>	<b>Q</b> #		V. 2	A Second		The second course			- N. S. C. C	2.30.4		<del></del>
*	EX	AM	INE	R M	) [[\$]	ر؟ د ر <sub>ي</sub>	: ५) . 4			DATE	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				F 1 . 4 . 1	Tarri Gy	<u> </u>	THE SECTION
	ΨĪ.	C,	ĀĒ	L	E	}	SH	iNi	SL	70N 3	8-200	<u>3</u>			<u> </u>			
	A copy of this reference is not being furnished with this office action.  (See Manual of Patent Examining Procedure, section 707.05 (a).)																	
				•														